

小間番号
Booth No.

招待会社名
Invited by

電子機器2025
トータルソリューション展

2025.6.4→6
Wed. Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト東展示棟

完全WEB登録制
事前登録

パッと登録！パッと入場！

事前登録のうえ、来場者バッジを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置の
バッジホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

来場登録はこちらの WEBから
▶www.jpccashow.com/

招待状

入場料：1,000円（税込）
WEB登録にて無料

www.jpccashow.com

第54回 国際電子回路産業展

第39回 最先端実装技術・パッケージング展

第26回 実装プロセステクノロジー展

AIデバイス展

～装置と装置をつなぐ～
WIRE Japan Show 2025
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JIEP 全国電子部品流通促進委員会
EESA 東京都電機部品流通促進委員会

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

会 期：2025年6月4日（水）～6日（金）10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟

入 場 料：1,000円（税込）※招待券持参者及びWEB登録で無料

本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会

運営事務局：株式会社ジェシーエス・コミュニケーションズ(JCSC)

後 援：経済産業省（予定）

海外協力：世界電子回路業界団体協議会（WECG）加盟団体
中国電子回路行业协会（CPCA）、欧州電子回路協会（EIPC）、インド電子工業会（ELCINA）、
香港線路板協会（HKPCA）、米国電子回路協会（IPC）、インド電子回路工業会（IPCA）、
韓国電子回路産業協会（KPCA）、タイ電子回路工業会（THPCA）、
台湾回路板協会（TPCA）
Association of Electronic Industries in Singapore(AEIS)
Korea Packaging Integration Association(KPIA)

電子機器トータルソリューション展 基調講演 **要事前登録**

セミナー会場A

6月4日（水）	6月5日（木）	6月6日（金）
AIと半導体が世界経済を引っ張る 主役の時代がやって来た！ ～後工程の重要性、チップレット、 パッケージ基板の高度化に注目～ 泉谷 渉 株産業タイムズ社 取締役 会長	日本の半導体戦略の現状と今後 清水 英路 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長	AFEELAにおけるモビリティの 新たな価値基準の創造 川西 泉 ソニー・ホンダモビリティ㈱ 代表取締役社長 兼 COO
未来を創る最先端半導体パッケージング技術 荒木 康 新光電気工業㈱ 開発統括部 上席執行役員 開発統括部長	IBM 地域 DX センターが掲げる官産学共創と 人材育成 ～チップレット・AI 半導体・工場自動化 などへの展開～ 山之内 裕一 日本アイ・ピー・エム㈱ 製造・流通・公益・ 統括サービス事業部 事業部長・常務執行役員	脳が語る未来： 柔軟・伸縮性エレクトロニクスが拓く 新たな生体センシング 関谷 毅 大阪大学 産業科学研究所 教授

JIEP 最先端実装技術シンポジウム **有料 要事前登録**

最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場（会議棟 6F）

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要です（VIP登録された場合も有料です）。会場区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。www.jpccashow.com/show2025/

	A 会場（会議棟 605・606） 4A-1 10:00-12:30	B 会場（会議棟 607・608） 4B-1 10:00-12:30
Time	5G/6G 向け高周波対応材料開発動向 座長：松本 博文、高野 希	半導体/PKG2025年展望 座長：土門 孝彰、森川 泰宏
10:00-10:50	4A-1 Beyond5Gに向けた高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向 広川 結樹 パナソニック インダストリアル㈱ 電子材料事業部 電子基材BU 商品開発部 開発一課 課長	4B-1 2025年以降の電子機器と半導体市場トレンドを読む 南川 明 インフォマティクス株式会社 コンサルティング シニアコンサルティングディレクター
10:50-11:40	4A-2 5G/6G に向けた低伝送損失基板材料の技術動向と評価技術 春日 圭一 株式会社エーエスエス 電子回路事業本部 開発センター 積層材料開発部 上級研究員	4B-2 成長のための「新斬新マーケティング戦略」 永田 隆一 アンカー・ビジネス・システムズ㈱ 代表取締役社長
11:40-12:30	4A-3 5G/6G に向けた BT レジン積層材料の技術開発動向 山崎 直樹 三菱化学㈱ 研究統括部 東京研究所 主任研究員	4B-3 新世代半導体パッケージ基板製造装置とプロセスのご紹介 山崎 英一 株式会社 微小材料システム事業推進室 マネージャー
Time	4A-2 13:30-16:00	4B-2 13:30-16:00
Time	光電融合技術の新潮流と最新動向 座長：中俣 徳男、谷 元昭	半導体とAI開発最新動向 座長：土門 孝彰、池田 浩昭
13:30-14:20	4A-1 スーパーコンピュータのインターコネクト技術動向と 光電コパッケージ技術への期待 安島 雄一郎 富士通㈱ 先端技術開発本部 システム開発統括部 プリンシパルアーキテクト	4B-1 AI がもたらす半導体業界への影響 山本 義徳 みずほ証券 エクティ調査部 シニアアナリスト
14:20-15:10	4A-2 800Gbps/1.6Tbps 実現に向けたの対応状況および技術課題 土屋 勝生 アリスデータワークスジャパン 合同会社 技術部 副技術部長	4B-2 半導体産業の明るい未来 和田本 哲也 Morgan Stanley MUFG 証券 調査統括本部 マネージングディレクター
15:10-16:00	4A-3 光×コンピューティングの研究動向 経瀬 道雄 国立情報科学研究所 アーキテクチャ科学研究室 教授	4B-3 AI 用半導体チップレットの最新動向 西尾 俊彦 SBR テクノロジー 代表取締役
Time	5A-1 10:00-12:30	5B-1 10:00-12:30
Time	生成 AI の最新動向、現状と課題 座長：西田 秀行、森川 泰宏	高機能・高密度化を実現する先端印刷技術の今 座長：佐藤 敦子、北原 悠平
10:00-10:50	5A-1 AI Hardware の現状と課題 山道 新太郎 日本アイ・ピー・エム㈱ 東京基礎研究所 セミコンダクター 理事	5B-1 高機能化を支える銅箔技術 森岡 伸博 福田金属箔工業㈱ 技術本部 研究開発部 EF 研究グループ グループマネージャー
10:50-11:40	5A-2 AI とコンピューティングの今とこれから 愛甲 清史 エヌビディア合同会社 エンタープライズマーケティング部 シニアマーケティングマネージャー	5B-2 微細配線対応銅めっきおよびエッチングプロセス 大野 晃寛 ㈱JCU 総合研究所 執行役員 総合研究所 副所長
11:40-12:30	5A-3 AI 向けアクセラレータ開発と光インターコネクト、現状と課題 平本 敬 Preferred Networks Senior Researcher	5B-3 メックの導体表面処理技術の開発ロードマップ紹介と、半導体向け 選択エッチング技術の紹介（仮） 吉海 雅史 メック㈱ 事業本部 事業統括部 企画グループ グループ長
Time	5A-2 13:30-16:00	5B-2 13:30-16:00
Time	新パワーモジュール3D実装の動向 座長：土門 孝彰、加藤 義尚	進化するパッケージ基板・インターポーザ 座長：谷 元昭、佐藤 敦子
13:30-14:20	5A-1 WBG/パワーデバイスの3D実装と通信・エッジコンピューティングの融合で 広がるパワーエレ・アプリケーション 中村 和人 名古屋大学 未来材料・システム研究所 パワーエレクトロニクス研究室 STROM Lab 代表	5B-1 先進半導体に対応した最新のパッケージ基板技術 栗田 健太郎 新光電気工業㈱ 開発統括部 アドバンストパッケージ開発部 主幹研究員
14:20-15:10	5A-2 パワーモジュールの高放熱化技術開発動向（仮） 山本 圭 三菱電機㈱ 先端技術総合研究所 先端パワーデバイス技術部 パッケージ技術グループ グループマネージャー	5B-2 Glass Substrate for Heterogeneous Integration 倉持 信 大日本印刷㈱ ファインパッケージング本部 フロー
15:10-16:00	5A-3 パワー半導体 GaN デバイスの社会実装を加速させるための取り組み 山口 雄平 ローム㈱ LSI 事業本部 電源・標準LSI 事業担当 パワーシステム商品開発部 部長	5B-3 チップレット集積PSB（ピラサスペンディングブリッジ）を中心とした アドバンストパッケージング群の半導体中工程技術について 河野 聡 オライ電子㈱ FOLP 事業部 参事
Time	6A-1 10:00-12:30	6B-1 10:00-12:30
Time	CHIPLET の最新動向、現状と課題（Player の取り組み） 座長：西田 秀行、森川 泰宏	モビリティ・GX と実装技術 座長：三宅 敏夫、武田 裕一
10:00-10:50	6A-1 半導体後工程の未来：チップレットパッケージング技術の革新 新井 靖光 Raspius㈱ 3D アセンブリ本部 専務執行役員・3D アセンブリ本部長	6B-1 先端車載 SOC 用パッケージングの技術動向～チップレット適用に向けて～ 渋谷 祐貴 Renesas Electronics Corporation Global Packaging & Assembly Division Package Research Principal Engineer
10:50-11:40	6A-2 Customization & Energy-efficiency Improvement with Advanced Packaging for AI Infra 刈谷 隆 日本エスエス㈱ Samsungデバイスソリューションズ研究所 Advanced Package Lab. Corporate Vice President, Top of Lab	6B-2 カーボンニュートラルに向けた電動化とパワーエレクトロニクス 堀田 幸司 ㈱ミラテックテクノロジー 執行役員
11:40-12:30	6A-3 TSMC の 3DIC 技術と日本の EC システムの融合で世界のインバースョンを生み出す 安原 隆太郎 TSMC ジャパン 3DIC 研究開発センター 企画・システムインテグレーション部門 テクニカルマネージャー	6B-3 自動車電動化および自動運転に対応した樹脂材料 寺岡 眞備 ポリアスチックス㈱ テクニカルリレーションセンター グループリーダー
Time	6A-2 13:30-16:00	6B-2 13:30-16:00
Time	CHIPLET の最新動向、現状と課題（Process/Architecture） 座長：西田 秀行、松澤 浩彦	応用急拡大が期待されるフレキシブル・ストレッチャブル3D 回路形成技術 座長：本多 達、猪川 幸司
13:30-14:20	6A-1 CMP 進化論：CMP for MM, MtM & BC（仮） 辻村 孝 ㈱在原製作所 コーポレート フェロー	6B-2 ウェアラブルデバイスに応用する伸縮FPC（Stretchable FPC）技術 松本 博文 フレックスリンク・テクノロジー㈱ 代表取締役社長
14:20-15:10	6A-2 モールディングの変遷と先端パッケージにおけるモールディング技術（仮） 家治川 祐一 TOWA ㈱ 市場開発部 シニアリーダー	6B-3 印刷法を用いたストレッチャブル・立体多層配線形成技術とその応用 鳥井 健一 ㈱アジクラ 電子部品開発部 主席技師
15:10-16:00	6A-3 ハイブリッド接合の業界/学会の最新動向、課題と期待について 井上 史大 横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 准教授	6B-3 アクアプラズマを用いたフルラフレキシブルデバイスの実装技術と応用例 横田 知之 東京大学 工学系研究科総合研究機構 准教授

JIEP アカデミックプラザ **無料 要事前登録不要**

セミナー会場E

	6月4日（水）	6月5日（木）	6月6日（金）
13:00-13:20	人体通信技術を用いたドローン型緊急システムへの検討 ～ドローン電機とウェアラブル電機の間の伝送特性～ 東京工芸大学	樹脂バインダ中でのスズ系フィラーの焼結現象の解析と導 電性接着剤への応用 国立大学法人 群馬大学	動力学シミュレーションを用いた多脚型マイクロロボットの 歩容解析 日本大学
13:20-13:40	床面電機とウェアラブル電機間の人体通信における 靴底条件に対する伝送特性の比較 東京工芸大学	真空成形中での動的パーコレーション誘導による 3次元導電性ペースト印刷配線の電気抵抗変動抑制 国立大学法人 群馬大学	3D モデルを用いた大腿骨ステム周囲骨折の電磁進展解析 日本大学理工学部
13:40-14:00	ガラス基板上のITO 透明導電膜を利用した コプレーナ線路の伝送特性の検討 東京工芸大学大学院	CNT 分散導電性ペーストにおける動的パーコレーションの 速度論制御のための材料設計 国立大学法人 群馬大学	MEMS マイクロロボットに実装可能なシリコンデバイスの 開発 日本大学理工学研究科 精密機械工学専攻
14:00-14:20	給電機をガラス基板上に配置した透明広帯域ダイオードアル テナの検討 東京工芸大学	樹脂バインダ中での銅サブリミットフィラーによる 導電性ペースト形成制御と導電性ペーストへの応用 国立大学法人 群馬大学	微生物培養における自動化を目的とした塗抹動作の解析 日本大学大学院理工学研究科
14:20-14:40	スパイラルコイルを利用した生体内外周通信における 生体内フィルの位置と傾きに対する伝送特性 東京工芸大学	可溶性樹脂バインダ配合設計による銀系導電性接着剤の マイクロフィラ焼結促進と接続特性向上 群馬大学大学院理工学部	カーネル主成分分析を適用したプリント基板加工用超硬ド リルのカタログデータマイニングの考察 同志社大学大学院生
15:00-15:20	カーボンナノチューブを用いた電波吸収材料の遮断 周波数制御に関する検討 東北大学 大学院工学研究科	Au 薄膜転写により作製したピラミッド型中空マイクロバ ンプを用いた 低温・低荷重接合 東北大学	Cuダイレクトレーザビーム加工で絶縁層内ガラスス クが形成状態に与える影響と画像二色法を用いた噴 出物の温度解析 同志社大学大学院生
15:20-15:40	もみ殻皮からなる樹脂複合シートの高周波伝導 ノイズ抑制機構 東北大学 大学院工学研究科	低温焼成接合を可能とする銅ナノ粒子系の構築 北海道大学 大学院工学研究院 米澤研究室	左右ボールねじカウンタバランス制御機構を有する穴あけ 工作機械の加工能力および品質を考慮したステップ動作 の検討 同志社大学大学院生
15:40-16:00	LSI パッケージ内蔵用ハイブリッド磁心ワイヤインダクタの 試作と特性評価 信州大学 工学部 電子情報システム工学科先端電気デバイス（曾根）研究室	ウェアラブルな塩分濃度計測センサーによる 全身喪失塩分濃度計測技術の開発 公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科	表皮効果損失抑制のための負誘導率材料を用いた矩形積 層伝送線路の非対称構造に対する基礎的研究 長野工業高等専門学校
16:00-16:20	高空間分解能磁界センサ用ハーフオープンループ 磁気ヨークの基礎検討 信州大学 工学部 電子情報システム工学科先端電気デバイス（曾根）研究室	誘電体加熱を用いた低温調理装置の試作とその加熱効果 東京理科大学大学院 創成理工学研究科電気電子情報工学専攻	
16:20-16:40		マウスへの磁界ばく露による筋動、認知機能に対する 作用の評価 東京理科大学	
16:40-17:00		マイクロ波マモグラフィに対応した乳房脂肪等価 電磁ファントムの開発に向けた一検討 東京理科大学 創成理工学部電気電子情報工学科	

事前来場登録のご案内

電子機器トータルソリューション展は**WEB登録制**となります。**事前にWEBにて登録**をお願いいたします。
本招待状のみでは入場できませんのでご注意ください。

STEP.1

公式ホームページより
来場登録へお進みください。

STEP.2

ご登録いただいたメールアドレス宛に、
パスワード設定のメールが届きます。
24時間以内にパスワードの設定を完了して
ください。
パスワード設定のメールが届かない場合は、
事務局までお問合せください。

STEP.3

展示会当日、来場者マイページより
来場者バッジをプリントアウトし、四つ折りの
状態でご持参ください。
バッジホルダーをピックアップいただき、
来場者バッジを中に入れ、会場入口にて
バーコードをご提示ください。

来場者参加型企画

ブースコンテスト

展示会オリエンテーション&ツアー

ブースコンテストを今年も開催！ナイスデザイン賞・特別賞が皆様の投票で決定
します。

学生の皆様に向け、オリエンテーションを開催し、終了後ツアーを実施します。

JPCA 賞 表彰式
優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を
促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術
の進歩発展を図っている出展者を表彰します。
6月4日（水） 16:40～17:00
於・セミナー会場C

半導体オープ・ザ・イヤー2025
受賞製品・技術発表
6月4日（水）
14:00～17:00（受付開始13：30～）
於・セミナー会場G

アカデミックプラザ表彰式
アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中
から、JIEP 展示会委員会が優秀な論文内容を選考
し、アカデミックプラザ賞受賞者を決定いたします。
6月4日（水） 16:40～17:00
於・セミナー会場E

JISSO PROTEC 特別講演 **無料 要事前登録**

セミナー会場G

6月4日（水）	6月5日（木）	6月6日（金）
スマートフォン・周辺機器、AI サーバーの 業界見通し みずほ証券株式会社 エクティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト	サイバートラック（テスラ）分解から読み解く 電動車用パワー半導体実装技術トレンドと 将来動向 中根 康夫 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授	JEITA 2024 年度版実装技術ロードマップ 【注目される市場と電子機器群】 西村 隆 一般社団法人電子情報技術産業協会 Jisso 技術ロードマップ専門委員会 委員長／ 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 先進パワーデバイス技術部 主席研究員

PROTEC セミナー **無料 要事前登録**

セミナー会場H

	6月4日（水）	6月5日（木）	6月6日（金）
11:45-12:30	SDGs に関係するディスプレイ技術と 液体材料について 武蔵エンジニアリング㈱ マーケティング戦略部 部長	Autonomous Factoryの実現へ ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～ パナソニック コネクト㈱ 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター マネージャー	【ものづくりの現場はどう変わる？オンデマンド AI と 実装技術の最新動向】 ～FUJII 技術開発ロードマップ2030 Target ZERO より～ 武野 祐丸 ㈱FUJII ロボットソリューション事業本部 営業企画部 マーケティング課
12:55-13:40	実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025 若林 利昌 ヤマハ発動機㈱ ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SP グループ 印刷プロセスエンジニア	実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025 若林 利昌 ヤマハ発動機㈱ ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SP グループ 印刷プロセスエンジニア	実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025 若林 利昌 ヤマハ発動機㈱ ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SP グループ 印刷プロセスエンジニア
14:05-14:50	進化し続ける FUJII Smart Factory ～3年の軌跡と未来への挑戦～ ㈱FUJII ロボットソリューション事業本部 スマートファクトリー 開発部 第4課 課長	【成功事例から学ぶ】部品管理の効率化と秘訣を 見学に来ませんか JUKI㈱ 産機ユニット ストレージビジネスカンパニー テクニカルグループ	Autonomous Factoryの実現へ ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～ パナソニック コネクト㈱ 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター マネージャー
15:15-16:00	Autonomous Factoryの実現へ ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～ パナソニック コネクト㈱ 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター マネージャー	サイクルタイム指定で印刷パラメータを提示 ～Printing Navigator～ ㈱FUJII ロボットソリューション事業本部 PM プロジェクト 部長	ゼロエミッション達成に貢献する、はんだ付け材料 榎本 裕 千住金属工業㈱ 研究開発部 瀬戸研究所 課長 上級研究員

がりんとばんじゅくセミナー **無料 事前登録不要**

セミナー会場B

	6月4日（水）	6月5日（木）	6月6日（金）
13:00-14:00	プリント配線板全般の基礎「がりんとばんじゅくI」をもとに解説 榎場 正男 ㈱カヤバオフィス 代表取締役	プリント配線板設計の基礎「がりんとばんじゅくII」をもとに解説 田中 弘文 エンジンエンジニアリング 代表	フレキシブル配線板の基礎「がりんとばんじゅくIII」をもとに解説 宮崎 博明 元 MF インフォメーション㈱ 代表
14:15-15:15	フレキシブル配線板の基礎「がりんとばんじゅくIV」をもとに解説 宮崎 博明 元 MF インフォメーション㈱ 代表		
15:30-16:30	実装の基礎「がりんとばんじゅくV」をもとに解説 榎場 正男 ㈱カヤバオフィス 代表取締役		
13:45-14:45	品質管理の基礎 安井 博文 安井事務所 PWB コンサルタント		

JEITA セミナー **無料 事前登録不要**

セミナー会場B

	6月5日（木）
10:00-17:00（仮）	JEITA チップレット関連セミナー ※詳細は展示会 WEB サイトにてご案内いたします。 電子情報技術産業協会（JEITA）

ダントツものづくりセミナー **無料 要事前登録不要**

セミナー会場C

	6月4日（水）	6月5日（木）	6月6日（金）
13:00	0604TK 【特別基調講演】生産性向上の時代における 地域スモール/JPCA ものづくりアカデミーの 役割 藤本 隆宏 東京大学名誉教授 / 早稲田大学教授	0605TS 【特別講演3】トヨタ現場管理 田中 正知 トヨタ自動車 OB ものづくり大学名誉教授 / J-コスト研究所代表	0606TS 【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する 全体最適の働き方イノベーション 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO
13:45	0604TK 【特別基調講演】資金上昇、人手不足、 原材料高騰の中での電子回路業界活性化は 生産性向上しかない！ 藤本 隆宏 東京大学名誉教授 / 早稲田大学教授	0605TS 【特別講演4】現場改善のJコストラ理論による 強化策（ROA） 田中 正知 トヨタ自動車 OB ものづくり大学名誉教授 / J-コスト研究所代表	0606TS 【特別講演6】月曜日が楽しみな会社しよう！ ～全体最適のマネジメント理論 TOC とは～ 岸良 裕司 ゴールドラット・ジャパン CEO
14:35	0604TI 【特別講演1】DX（デジタルトランスフォーメーション）による DX の融合は日本企業の DX 成功の 要件 一カ 知一 パナソニックコネクト㈱エグゼクティブコンサルタント・ エンジニアリスト・ 京都女子大学データサイエンス学部客員教授	0605SI ※ JPCA ものづくり大賞 / 準大賞受賞(2023年度) 改善取り組み事例報告3件 大賞受賞 株式会社 津島製作所 春日井工場 津島製作所 九州工場・太田工場製造課 課長	0606SI 【特別講演7】電子回路ものづくり企業の 「現場改善」について 「お金の良い流れ」から考える 岸良 裕司 愛知工業大学経営学部経営学科教授
15:20	0604TI 【特別講演2】IE（インダストリアルエンジニア リング）と DX の融合は日本企業の DX 成功の 要件 一カ 知一 パナソニックコネクト㈱エグゼクティブコンサルタント・ エンジニアリスト・ 京都女子大学データサイエンス学部客員教授	0605SI ※ JPCA ものづくりアカデミー校長 / JPCA 顧問・E-ESMAP 研究会特別顧問 山本 治彦	0606SI 【特別講演8】経営者は何を管理すれば 現場改善効果を見える化できるのか 「現場改善会計（GKC）」 岸良 裕司 愛知工業大学経営学部経営学科教授

デモンストレーション／体験 **※デモンストレーションの詳細は公式HPをご参照ください。**

東7ホール内特設会場

脳波ゲーム体験

疲労・ストレスの計測

技術提供：㈱アラヤ / Visionary Lab「Colors」

大坂大学 関谷研究室、PGV 株式会社

技術提供：㈱村田製作所

※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早めの受付にご協力をお願いいたします。

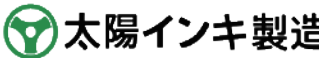
	セミナー会場 D（オープン）	セミナー会場 J（オープン）	セミナー会場 K（クローズド）
6月4日（水）	11:50-12:10 EMI対策基板設計の最前線 実測・解析・チェックツールを活用した効率的なアプローチ 株式会社オンテック	フレキシブル・プリントドエレクトロニクス向け新規デバイス 作製の効率アップへ、研究開発用電子回路プリントNOVA テクノアルファ㈱	
	13:30-13:50 ガラス・フィルム用レーザ加工システムの紹介 進谷工業㈱	当社負熱膨張材料のご紹介と社会実装に向けた開発 三井金属鉱業㈱	次世代低反りBTレジン積層材料の紹介 三菱ガス化学㈱
	14:10-14:30 BGAリワーク革命、WFCの省エネリワーク工法 ㈱ワンダーフューチャーコーポレーション	超微細かつ高精度を実現する次世代SAP用アルミ箔の 最新状況 東洋アルミニウム㈱	ウルトラファインピッチを実現する次世代シリキュレーション 三晃技研工業㈱
	14:50-15:10 信頼性試験でも使える！ BGA実装基板検査の課題を解決する JTAGパワングリスキャンテストのご紹介 アドーナルシステムサポート㈱	超低DF・低CTE ぶっ素フィルムのご紹介 ニチアス㈱	ボイドレスTGV（Through Glass Via）フィリング向け 電解銅めっきプロセス 上村工業㈱
	15:30-15:50 最新ダイレクト露光装置のご紹介（仮） ㈱オーク製作所	リフロー実装対応部品の保管期間に対応する信頼性技術 の紹介 TDK㈱	
6月5日（木）	10:30-10:50 ガラスコア基板向け高アスペクトホールフィリング 硫酸銅めっき添加剤「トップルチナGCSシリーズ」 奥野製薬工業㈱	プリント配線板およびその材料に求められるUL規格試験 とDAP（UL認証試験）サービスのご紹介 ㈱ケミックス	
	11:10-11:30 ENEPIGプロセス・めっきマスキング用ドライフィルム [ALPHO® AUP1000シリーズ] のご紹介 長興材料工業㈱	放熱材料の熱抵抗・熱伝導率評価サービスのご紹介 ㈱ケミックス	
	11:50-12:10	世界最高レベルのエリアレーザ技術によるレーザリフロー ナラサキ産業㈱	
	13:30-13:50 水分の影響を受ける樹脂物性とその評価手法：温湿度制 御下での解析 ティー・エイ・インストルメント・ジャパン㈱	ラボからプロセスまで、薬液分析を自動化してみませんか？ メロームジャパン㈱	SCREENからの新しい直接描画機のご紹介 ㈱SCREEN PEFソリューションズ
	14:10-14:30 電子材料分野で活躍するテルベン系溶剤 日本テルベン化学㈱	表面研磨機ラインナップについて ㈱石井表記	ダイナトロン㈱部品実装関連製品のご紹介 ダイナトロン㈱
6月6日（金）	14:50-15:10 最先端エレクトロニクスを支える新材料ソリューション 旭化成㈱	数千万円の翻訳外部委託コストをAIで削減 シストランジャパン（同）	LTspiceを回路設計と基板評価に活用するヒント ㈱三共社
	15:30-15:50 デバイス材料の開発を支える材料分析の新展開 ティー・エイ・インストルメント・ジャパン㈱	微細加工用途エキシマレーザー加工装置のご紹介（仮） ㈱オーク製作所	LTspiceを回路設計と基板評価に活用するヒント ㈱三共社
	16:10-16:30 ガラス・フィルム用レーザ加工システム 進谷工業㈱		
	10:30-10:50 プラズマ処理を変える！ マイルドプラズマ®～低誘電フィ ルムと銅箔の直接接合による次世代CCL～ エステック㈱	SDGsに関係するディスパense技術と液体材料について 武蔵エンジニアリング㈱	
	11:10-11:30 LDX基板（環境型基板）のご提案-全世界のプリント基 板でのCO2排出量削減への貢献- シライ電子工業㈱	ラボからプロセスまで、薬液分析を自動化してみませんか？ メロームジャパン㈱	
6月6日（金）	11:50-12:10 【JPCA初出展】 サカタインクスの新規導電材料の取り組 み（回路材料、接合材料など） サカタインクス㈱	半導体プロセスの歩留まり、デバイス製造の品質向上に寄与するクリティカルな 分子汚染物質のリアルタイムモニタリングを実現スISTOPWERK社製質量分 析計Vocus CI-TOPMS テクノアルファ㈱	
	13:30-13:50 最先端エレクトロニクスを支える新材料ソリューション 旭化成㈱	三井金属の銅箔製品のご紹介 三井金属鉱業㈱	電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオンツール㈱
	14:10-14:30 信頼性試験でも使える！ BGA実装基板検査の課題を解決する JTAGパワングリスキャンテストのご紹介 アドーナルシステムサポート㈱	超微細かつ高精度を実現する次世代SAP用アルミ箔の 最新状況 東洋アルミニウム㈱	熟練ノウハウで生成AI：基板設計メーカーが作った “実戦型配置AI” ㈱オンテック
	14:50-15:10 速硬化、局所加熱に対応したIHリフロー硬化接着剤の 開発 協立化学産業㈱	基板クリーナーにおける静電気制御 ～スマートファクト リー化に対応したTeknek社の基板クリーナー～（仮） ㈱ブルックスジャパン	
	15:30-15:50 炭化無し・基板分割はクリーンなレーザーカットの時代へ （仮） ㈱ブルックスジャパン		

 スポンサー企業一覧

プラチナ



ゴールド



シルバー



ブロンズ



 出展者一覧

2025年4月9日（水）現在（展示会別・50音順・法人格省略）							
JPCA Show	santec	日本アグファマテリアルズ	四会富仕電子科技	半導体パッケージング・部品内蔵技術展	東芝情報システム	電気通信大学	マイクロ・テック
	シーエスワイ	日本エバレット・チャールス	富士電路	国内	富士電子	電磁材料研究所	マルコム
プリント配線板技術展	JSR	日本化学工業	GIS Tech	エクシール	マウビック	東京工芸大学	武蔵エンジニアリング
国内	JCU	日本サーキット	栄信（香港）电路板	奥野製薬工業	山勝電子工業	東京理科大学	ヤマハ発動機
愛工機器製作所	J-RAS	日本製銅所	Goal Searchers Zhuhai	オックスフォード・インストゥルメンツ	海外	東京理科大学	ルックス電子
相信	四国化成工業	日本テルベン化学	群翔工業	清川メッキ工業	台強電機	東北大学	海外
アイン	進谷工業	日本電子回路工業会（JPCA）	広東駿亜電子科技	協立化学産業		東北大学 日暮研究室	ESSEGI AUTOMATION
赤羽産業	ジャブロ工業	日本電波	Guangdong Yinghua Electronic Materials	クボテック		日本大学 金子研究室	Planar Motor
旭化成	上海山崎电路板	日本パーズ	深圳市艾诺信实业	コネクテックジャパン		日本大学理工学部精密機械工学科	ペントロン
アスリートFA	松和産業	日本ビークス	江蘇蘇杭電子	サカタインクス		北海道大学	
アドウェルズ	ショーダテクトロン	ハイケム	江西江南新材料科技	新光電子	サンエナジー	山形県工業技術センター	
アドテックエンジニアリング	シライ電子工業 国内・海外営業本部	ハイロックス	Jiangxi Xinjinhui Intelligent Technology	STAR-J	TEGソリューション	山形大学	
アトテックジャパン	シライ電子工業 ソリューション事業本部	伯東	建滔积层板	高田工業所	ミカドテクノス	山口東京理科大学	
アポロ技研	信越化学工業	パスコン	Lianmeng Electronics (Huiyang)	東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	リケン NPR	横浜国立大学	
アラヤ Visionary Lab	真華成	ピアメカニクス	PanelSemi	東洋アルミニウム			
アルゴ	伸光製作所	日立ハイテック	PCBGOGO		eX-tech		
アルメックステクノロジーーズ	新興電気	平山ファインテクノ	PCBWay	TOWA	I-PEX		
イー・エス・アイジャパン	SCREEN GP ジャパン	ファインテック	億鴻工業	TOPPAN	秋田化学工業		
EME	SCREEN PE エンジニアリング	フィッシャー・インストルメンツ	シュモール・マシネン	内藤電誠工業	アテネ		
石井表記	SCREEN PE ソリューションズ	ブイ・テクノロジー	SET	ニチワ工業	アンドールシステムサポート		
石原ケミカル	SCREEN ホールディングス	フェイス	Shandong Shengquan Electronics Materials	日機装	イープロニクス		
イチカワテクノファブリクス	ステラ	福田金属箔粉工業	Shenzhen Han's CNC Technology	日放電子	エキシール AB		
いのちを守る@プロジェクト JAPAN	ステラ・コーポレーション	不二越	Shenzhen JCD Circuit Tech	日本電気硝子	エスペック		
伊原電子工業	スマート・ソリューション・テクノロジー	富士プリント工業	Shenzhen Jinxin Technology	フォアサイト	エンジニアリング・ラボ		
インスペック	セリアコーポレーション	ブルックスジャパン	SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY	フジ機工	大阪有機化学工業		
上村工業	souco	ベアック	Shenzhen Londian Wason Technology	マクセル	奥野製薬工業		
ウシオ電機	大日光・エンジニアリング	ポルックステクノ	深圳メイニン電子	三井化学分析センター	カネカテクノリサーチ		
ヴェオールイメージング	太陽インキ製造	マイクロクラフト	深圳市ニューセス実業	三井金属鉱業	KMT技研		
EIZO	ダイワ	マコー	Shenzhen SAM Electronic Equipment	リゴルジャパン	サイバネットシステム		
エイト工業	ダイワ工業	マックエイト	SHENZHEN SHEN EATAUNT ELECTRONIC	ワンダーフューチャーコーポレーション	JNC 石油化学		
エーディーエステック	高千穂交易	丸源鐵工所	Shenzhen SUREU Technology	海外	KASTON		
エステック	高松帝酸	丸文	SHENZHEN TIANXI SCIENCE DEVELOPMENT		韓国実装産業協会（KPPIA）		
NTW Inc.	タケウチ	ミクナス DT ソリューションズ	ShenZhen XinJiaYe Electronics Technology		Shenzhen Technology Trust Precision Industry		
FTM テクニカルサービス	田原電機製作所	ミクロ技術研究所	嵩台資訊		Tangshan Huixun Electronic Technology		
オーク製作所	ちの技研	三菱ガス化学	Sunshine Global Circuits				
大阪大学	チュールupp	三菱電機	碩頂精密工業				
大船企業日本	長興材料工業	ムラキ	Suzhou Tztek Technology				
オカダジーエージェイ	角田ブラシ製作所	村田製作所	TAESUNG				
オンテック	ティーシーティー・ジャパン	メイコー	台湾軟電				
笠原理化学工業	DDP スペシャルティ・プロダクツ・ジャパン	メック	提凱貿易（上海）				
華正新材料	Tebiki	メトロームジャパン	利恵（澳門）線路				
北川精機	デンカ	モトロニクス	WECC（世界電子回路業界団体協議会・CPCA、EIPC、ELCINA、HKPCA、IPC、IPCA、KPCA、THPCA、TPCA）				
協栄プリント技研	電気化学システムズ	ユニオンツール	偉勝乾燥工業				
京写	電子回路企業年金基金	ヨシミツ理化	盈華電子科技				
キョウデン	電子情報技術産業協会（JEITA）	ライズエレクトロニクス	Yiyang Jindong Technology				
共立エレクトクス	東海神栄電子工業	利昌工業	ZHEJIANG EMIDA PUMPS				
金陽社	東京マシン・アンド・ツール	令和マテリアル					
クラボウ	東光技研工業	レコーン工業					
黒金化成	東レ・デュボン	ローデ・シュルツ・ジャパン					
ケミックス	トーア電子	海外					
ケミトロニクス	巴工業	ACCUTECH(SHENZHEN)					
ケミロン	ナラサキ産業	Addison Clear Wave Coating					
相模ピーシーアイ	ニチアス	atg luther & maelzer					
ZACROS	ニッカン工業	CHEON WESTERN (CHINA) GROUP					
佐藤商事	ニッコー・マテリアルズ	China Circuit Technology (Shantou)					
山栄化学	日駿	東莞市同亞電子科技					
三晃技研工業	日達化成	戴伟思新材料（广东）					
サンテック	ニデックアドバンステクノロジー	紋豊企業					

	6月4日（水）
10:15-10:45	MIDの概要と日本MID協会の活動紹介 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 三共化成㈱
11:00-11:30	フェムト秒レーザを用いた回路形成技術 目黒 和幸 岩手県工業技術センター 電子情報システム部 上席専門研究員
11:45-12:15	JEITA・日本MID協会の実装用MIDテクニカルレポート 坂本 一三 電子情報技術産業協会（JEITA）電子実装技術標準化専門委員会 主査
	6月5日（木）
10:15-10:45	MIDの概要と日本MID協会の活動紹介 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 三共化成㈱
11:00-11:30	WFCが実現するこれまでとちがうMID工法 岡庭 年春 ㈱ワンダーフューチャーコーポレーション 営業本部営業部 代表取締役部長
11:45-12:15	JEITA・日本MID協会の実装用MIDテクニカルレポート 坂本 一三 電子情報技術産業協会（JEITA）電子実装技術標準化専門委員会 主査
	6月6日（金）
10:15-10:45	MIDの概要と日本MID協会の活動紹介 吉澤 徳夫 日本MID協会 監事 三共化成㈱
11:00-11:30	3D-MID&次世代先端半導体パッケージ設計環境のご紹介 松澤 浩彦 ㈱図研 技術本部 EL開発部 シニアパートナー
11:45-12:15	WFCが実現するこれまでとちがうMID工法 岡庭 年春 ㈱ワンダーフューチャーコーポレーション 営業本部営業部 代表取締役部長

 Electronics Component & Unit Show

出展者プレゼンテーション

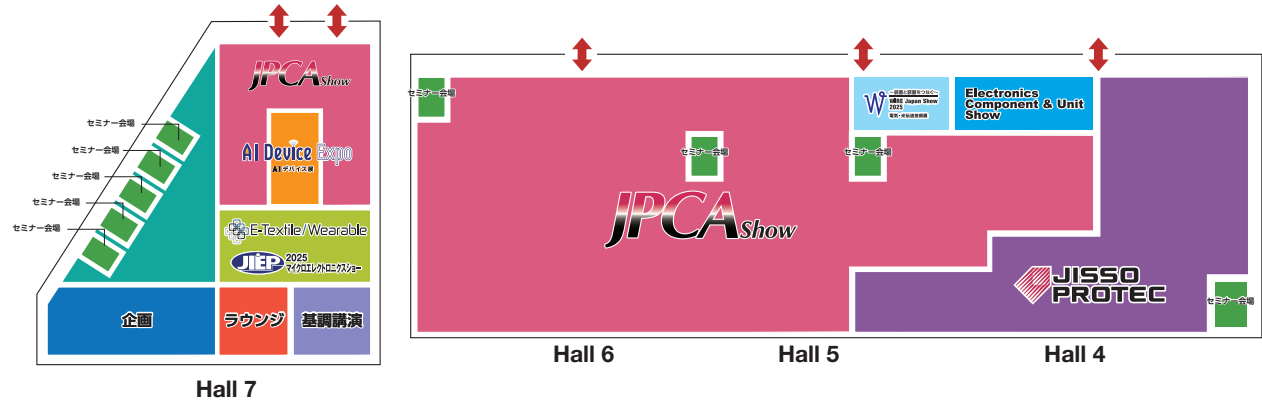
無料

事前登録不要

セミナー会場D

	6月5日（木）
11:45-12:15	“在庫処分”から“在庫活用”へ！新しい在庫マネジメントの提案 山口 麗美 コアスタッフ㈱ 第3Business Unit SBU1 インサイド営業担当

展示ホール内ゾーニング



	6月5日（木）
10:30-12:00	知って得する営業員向けセミナー 一色 和彦／渡邊 喜夫／中山 務 JPCA PWBコンサルタント
13:00-14:30	購入側から見たプリント配線板メーカーの選定方法（入門編） 鈴木 貴人／伊藤 直樹 JPCA PWBコンサルタント
15:00-16:30	知って得する基板製造技術セミナー（中級編） 一色 和彦／渡邊 喜夫／保坂 三喜雄 JPCA PWBコンサルタント

 PWB コンサルタントスキルアップセミナー

無料

事前登録

セミナー会場L

対象	PWBコンサルタント、PWBインストラクタ1級・準1級資格保有者のみ
6月6日（金）15:00～16:45	

 E-Textile/Wearable 展 基調講演

無料

事前登録不要

セミナー会場I

	6月4日（水）
14:30-15:20	陸上自衛隊化学学校の研究におけるE-スマートテキスタイルの活用 大江 京子 陸上自衛隊 化学学校 主任研究官

 E-Textile/Wearable 展セミナー

無料

事前登録不要

セミナー会場I

	6月4日（水）
10:00-12:00	快適と感動を創る！：スマートテキスタイルの力（仮）※ トテキスタイル製品化研究会
	6月5日（木）
10:00-12:00	快適と感動を創る！：スマートテキスタイルの力（仮）※ トテキスタイル製品化研究会
15:15-16:05	E-スマートテキスタイルに関する国際標準化動向と社会実装にむけての課題 前田 郷司 広島市立大学
	6月6日（金）
10:00-12:00	快適と感動を創る！：スマートテキスタイルの力（仮）※ トテキスタイル製品化研究会

※詳細は展示会WEBサイトにてご案内いたします。